

台灣技術交易資訊網 專利/技術流通快報

電子報主題
PCB 電路板設計專利組合讓售
專利/技術簡介
<p>本 PCB 電路板設計專利組合為 2 案 5 件之發明專利，為京元電子所有，佈局國家包含 TW、CN、US，包含 PCB 電路板設計相關之專利。</p> <p>本專利組合技術主要是與印刷電路板相關之技術，包含利用基因演算法決定印刷電路板之堆疊設計系統與方法以及判斷印刷電路板上的孔位是否位於其電源區(或接地區)內；解決人工作業計算繁雜之困擾並縮短設時間，可快速得到最適合之堆疊模式以提供設計者參考使用、可增加測試的正確性，減少測試異常的發生。</p>
專利/技術效益(應用領域)
<p>本專利組合為有關於印刷電路板之技術，特別是電路板設計以及電源區(或接地區)內孔位的自動檢查方法，可廣泛應用於印刷電路板產業，以應用端而言(即會進行印刷電路板採購，並應用到後端產品上)，一般而言，印刷電路板的應用端包括下面四類：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 資訊類— 主要為電腦及其週邊產品。2. 通訊類— 主要為手機、通訊網路系統、數據機等。3. 消費性產品— 如電動玩具、錄放影機、電視機、印表機等。4. 汽車相關電子化產品— 主要有各類汽車用控制板，衛星導航系統及結合辦公、娛樂等車上應用產品。
專利/技術發展現況
<p>印刷電路板產業發展已歷時 30 年以上，目前已廣泛使用於電子產品中，具有乘載電子零件、傳遞電源及訊號、絕緣乃至於散熱等功能。</p> <p>而傳統印刷電路板由於產品技術層次低，市場供過於求使得產品價格快速下滑，使得 PCB 廠商積極切入新產品線，如線路密度更高的 HDI 板、具有繞曲特性的軟板、高階 IC 封裝用之 IC 載板及軟硬結合板。</p> <p>在科技化電子產品強調輕薄短小、可折撓性的趨勢後，軟式印刷電路板將有很大的成長空間，而它的發展並能使相關電子產業更加蓬勃。隨著資訊科技之日新月異，輕、薄、短、小與使用便利性對現代社會愈形重要，因其具備可撓性、體積輕巧及可三度配線的特性，特別適合應用在可攜式電子產品上，隨著近年來筆記型電腦、手機、PDA 等產品大幅成長，以及</p>

LCD 監視器佔有率快速提高的趨勢，軟式印刷電路板的產值也呈現高度成長的態勢。

相關專利清單

核准國	專利申請號	專利名稱	專利起訖期
TW	096127617	印刷電路板之堆疊設計系統、方法、裝置與電腦可讀取記錄媒體	20101211~20270726
CN	200710141741.1	印刷電路板的堆疊設計系統與方法	20110413~20270820
US	11/970,744	Method for stacked pattern design of printed circuit board and system thereof	20110111~20280107
TW	097128929	印刷電路板之電源區與接地區之配置方法	
US	13/233,121	METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING DISPOSITION OF VIA HOLE ON PRINTED CIRCUIT BOARD	

流通方式：

一般授權 專屬授權 讓與 合作開發 面議

聯絡窗口：

台灣技術交易資訊網,廖小姐 03-5917711,fion@itri.org.tw